

谨慎推荐（维持）

国内半导体材料龙头企业，参股公司有望为科创板标的

风险评级：中风险

上海新阳（300236）深度报告

2019年2月22日

投资要点：

李隆海

SAC 执业证书编号：

S0340510120006

电话：0769-22119462

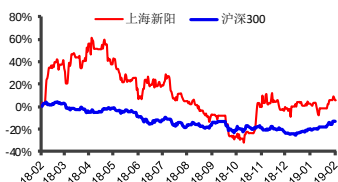
邮箱：LLH@dgzq.com.cn

主要数据

2019年2月21日

收盘价(元)	26.18
总市值(亿元)	50.73
总股本(亿股)	193.77
流通股本(亿股)	190.22
ROE(TTM)	0.99%
12月最高价(元)	39.80
12月最低价(元)	16.20

股价走势



资料来源：东莞证券研究所，Wind

相关报告

■ **公司简介：国内半导体材料龙头企业。**公司是一家专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务。公司主营业务产品产能情况：引线脚线表面处理化学品产能5600吨/年，晶圆镀铜、清洗化学品产能2000吨/年，晶圆划片刀产能5000片/月，公司在半导体传统封装领域已经成为国内市场的主流供应商。另外，公司2012年收购江苏考普乐涂料有限公司，拥有1万吨特种工业涂料产能。公司公告，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润500-900万元，同比下降87.57%-93.09%。公司盈利大幅下降的主要原因是2018年公司对2013年收购的考普乐计提商誉减值5958.27万元。

■ **半导体材料：进口替代空间巨大，受益下游产能大幅扩张。**在半导体材料领域，高端产品市场技术壁垒较高，国内企业长期研发投入和积累不足，我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域，高端产品市场主要被美、日、欧、韩、台湾等少数国际大公司垄断，国内大部分产品自给率较低，基本不足30%，主要依赖于进口。根据海关数据统计，我国近十年芯片进口额每年都超过原油进口额，2018年我国芯片进口额为3120.58亿美元，同比增长19.8%，贸易逆差2274.22亿美元。2014年，国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》。在市场需求和政府政策鼓励推动下，国产集成电路产业销售额近三年符合增长率达20%。2018年1-6月中国集成电路产业销售额达到2726.5亿元，同比增长23.9%。

■ **参股公司上海新昇有望成为科创板第一批上市标的。**上海新昇（公司持股27.56%）是我国第一家实现12英寸大硅片量产的国内企业。2018年一季度末，公司300mm硅片正片通过上海华力微电子公司的认证并开始销售；2018年底前公司大硅片已通过中芯国际认证。上海新昇2017年收入为2470万元，净利润亏损2588万元；2018年上半年上海新昇营业收入为7825.89万元，净利润1014.56万元。公司2018年底月产能达到10万片，2020年底前将实现月产30万片产能目标，最终将达到100万片的产能规模。随着认证的通过，产品销售将迎来爆发式增长。

■ **投资建议。**随着国家坚定推动集成电路产业发展，集成电路存在巨大进口替代空间，我国集成电路迎来黄金发展期。国内外半导体龙头也不断在国内新建产能，半导体产业链将快速发展。上海新阳作为国内的半导体材料龙头企业，可以说是国内半导体材料的稀缺标的，大部分产品是下游主流厂商的国内唯一供应商，公司将充分受益行业景气。我们预计公司2018年、2019年每股收益分别为0.04元、0.46元，目前股价对应PE为702倍、57倍，给予公司“谨慎推荐”投资评级。

■ **风险提示：**产品需求低于预期，大硅片项目投产低于预期。

目 录

1. 公司简介：国内半导体材料龙头企业	3
2. 半导体材料：进口替代空间巨大，受益下游产能大幅扩张	5
3. 参股公司上海新昇有望成为科创板第一批上市标的	8
4. 公司持续高研发投入	11
5. 投资建议	12

插图目录

图 1：公司主营业务在半导体产业链中所处位置	3
图 2：引线脚表面处理电子化学品主要应用于半导体封测领域	4
图 3：晶圆电镀、晶圆清洗电子化学品主要应用于晶圆制造领域	4
图 4：公司营业收入和净利润情况（亿元）	4
图 5：公司主营业务收入结构（2018H）	4
图 6：半导体材料市场规模占比	5
图 7：我国近年来集成电路产业销售额维持 20% 的增速	6
图 8：我国集成电路进口额高达 2000 亿美元之上，进口替代需求大	8
图 9：12 英寸大硅片	9
图 10：2015 年全球 300mm 大硅片市场份额	10
图 11：全球硅片出货量（应用于半导体生产）（单位：百万平方英尺）	10
图 12：公司持续高研发投入	11

表格目录

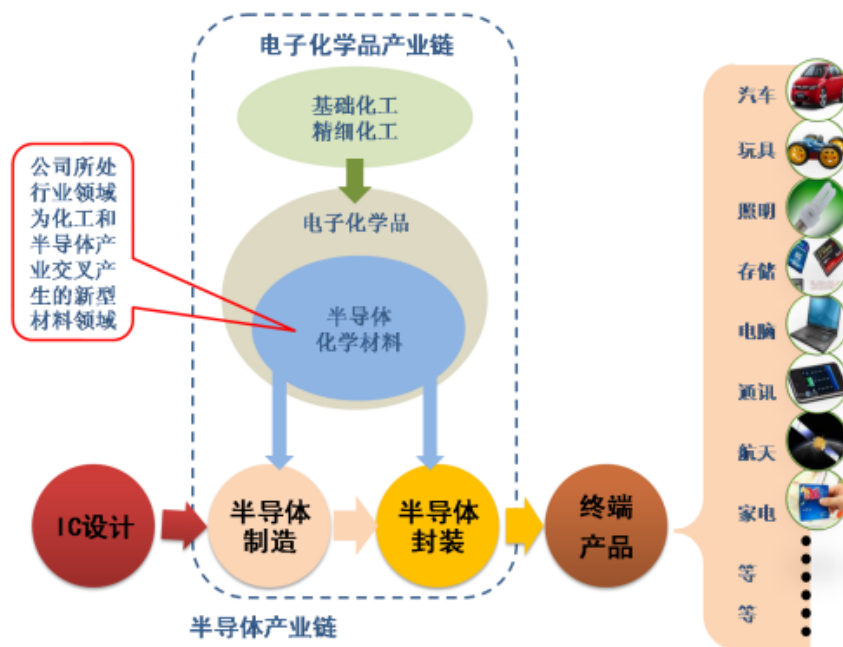
表 1：公司主营业务产品	3
表 2：不同种类半导体材料的国产化程度	5
表 3：2015 年-2030 年《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标	7
表 4：国内在建晶圆产线	7
表 5：上海新昇最新股权结构	9
表 6：公司盈利预测简表	13

1. 公司简介：国内半导体材料龙头企业

公司是一家专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务，同时开发配套的专用设备，致力于为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案的企业。公司主营业务产品产能情况：引脚线表面处理化学品产能5600吨/年，晶圆电镀、清洗化学品产能2000吨/年，晶圆划片刀产能5000片/月，公司在半导体传统封装领域已经成为国内市场的主流供应商。另外，公司2012年收购江苏考普乐涂料有限公司，拥有1万吨特种工业涂料产能，主要是氟碳涂料和重防腐涂料。

公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子三家客户，其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际第一供应商，用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都分别开始供货，另外，公司已经被台湾积体电路制造公司（TSMC）列入合格供应商名录，并开始产品验证事宜；在IC封装基板领域，公司的电镀铜添加剂产品仍处于少量供货阶段；在半导体湿法设备制造方面，公司增资子公司新阳电子化学并引进新的投资方，共同打造亚洲唯一完整的半导体湿法设备与药液一体化的技术平台。

图1：公司主营业务在半导体产业链中所处位置



资料来源：公司招股说明书，东莞证券研究所

另外，公司积极布局集成电路产业链。公司在2014年6月出资成立上海新昇半导体科技有限公司，切入300mm大硅片领域，实现大硅片首次国产化。

表 1：公司主营业务产品

产品	介绍
引线脚表面处理电子化学品	主要应用于半导体封测领域，对塑封后的半导体引线脚进行去毛刺（封装溢料）和电镀的工艺，目的是去除残留在引线脚等处的封装溢料（俗称“毛刺”），并在引线脚上通过电镀工艺形成可焊性功能镀层，保证封装产品焊接到 PCB 板上的质量和可靠性。公司产能5600吨/年。
晶圆电镀、晶圆清洗电子化学品	主要应用于晶圆制造领域，晶圆制造过程就是在硅圆片上进行各种物理的、化学的处理，制造出数以万计、甚至千万计的互相连通的单元电路。公司产能2000吨/

年。

划片刀

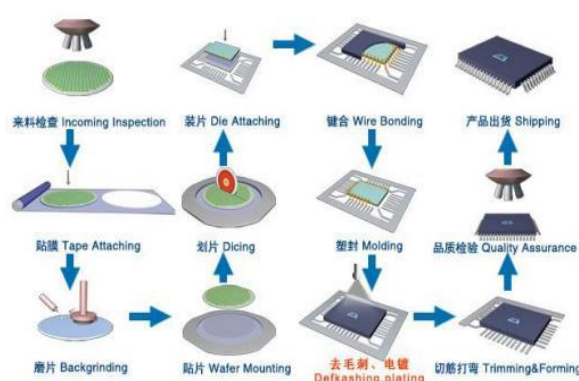
一般由金刚石（钻石）构成，用于将整片晶圆切割成单个芯片，由于切割集成电路需要较高的精度，导致产品技术含量高。全球划片刀市场参与者一共有 10 家左右，主流厂商包括日本 DISCO、以色列 ADT、美国 K&S 等。其中日本 DISCO 是知名后道工序设备制造商，其产品总体市占率达到 70%。目前产能可达 5000 片/月，未来产能目标为 5 万片/月。

氟碳涂料

业务隶属于公司于 2013 年收购的常州考普乐，产品被广泛应用于火车站、大型场馆、校园工程、商业地产等大型建筑领域。

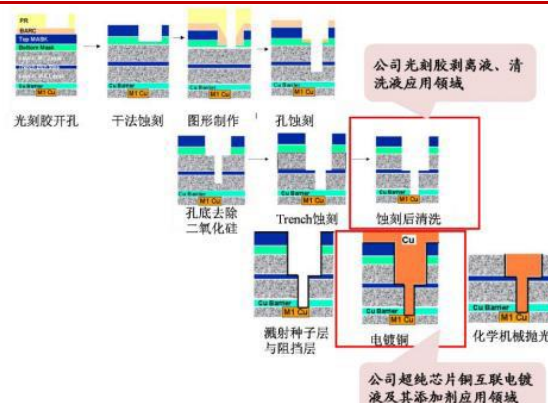
资料来源：公司公告，东莞证券研究所

图2：引线脚表面处理电子化学品主要应用于半导体封测领域



资料来源：wind资讯，东莞证券研究所

图3：晶圆电镀、晶圆清洗电子化学品主要应用于晶圆制造领域



资料来源：wind资讯，东莞证券研究所

2018年前三季度，公司实现营业收入3.94亿元，同比增长8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-255元，同比下降104.45%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-868万元，同比下降115.37%；实现EPS为-0.01元。业绩亏损的主要原因是公司计提资产减值损失6162万元，主要来自于公司对2013年收购的考普乐计提商誉减值5958万元。

公司公告，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润500-900万元，同比下降87.57%-93.09%。公司第四季度预计实现归属于上市公司股东的净利润755-1155万元。

图4：公司营业收入和净利润情况（亿元）

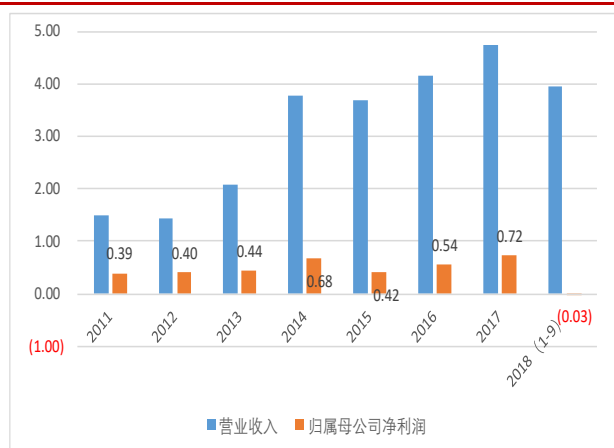
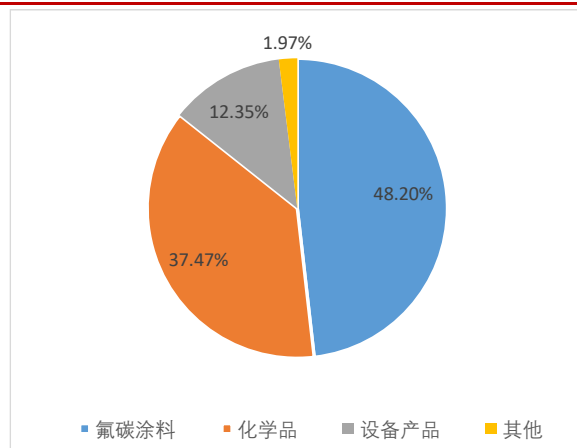


图5：公司主营业务收入结构（2018H）

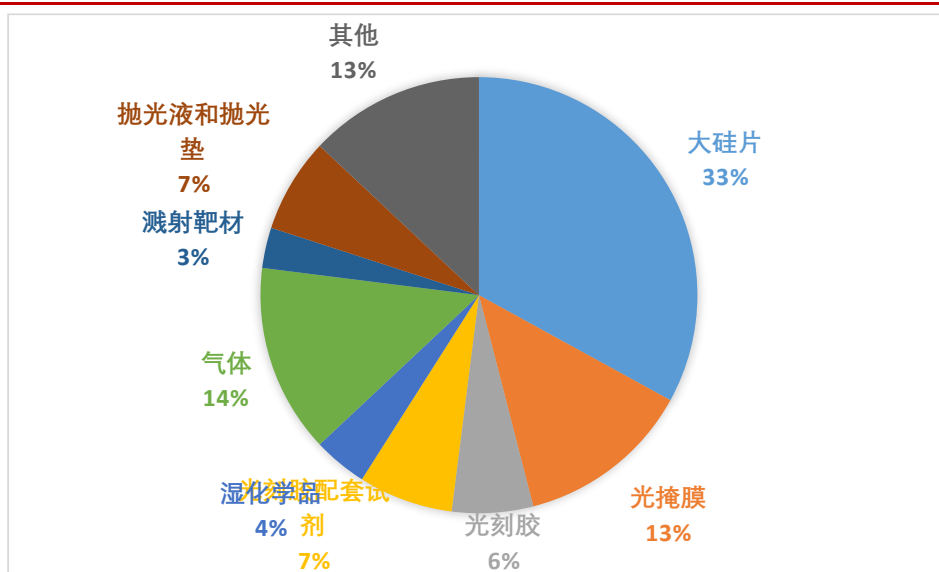


2. 半导体材料：进口替代空间巨大，受益下游产能大幅扩张

半导体材料是指电导率介于金属与绝缘体之间的材料，半导体材料的电导率在欧/厘米之间，一般情况下电导率随温度的升高而增大。半导体材料是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。

半导体材料市场可以分为晶圆材料和封装材料市场。其中，晶圆材料主要有硅片、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助设备、湿制程、溅射靶材、抛光液、其他材料。封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部填充料、液体密封剂、粘晶材料、锡球、晶圆级封装介质、热接口材料。

图6：半导体材料市场规模占比



资料来源：SEMI，东莞证券研究所

半导体材料自给率低

在半导体材料领域，由于高端产品技术壁垒高，国内企业长期研发投入和积累不足，我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域，高端产品市场主要被欧美日韩台等少数国际大公司垄断，比如：硅片全球市场前六大公司的市场份额达 90%以上，光刻胶全球市场前五大公司的市场份额达 80%以上，高纯试剂全球市场前六大公司的市场份额达 80%以上，CMP 材料全球市场前七大公司市场份额达 90%。

国内大部分产品自给率较低，基本不足 30%，并且大部分是技术壁垒较低的封装材料，在晶圆制造材料方面国产化比例更低，主要依赖于进口。另外，国内半导体材料企业集中于 6 英寸以下生产线，目前有少数厂商开始打入国内 8 英寸、12 英寸生产线。

表 2：不同种类半导体材料的国产化程度

材料类别	用途	相关企业	国产材料市场占比
硅晶片	全球 95%以上的半导体芯片和器件是用硅片作为基底功能材料生产出来的	有研硅研、浙江金瑞泓、合晶、国盛、上海新傲、上海新昇	主要以 6 寸及以下为主，少量 8 寸，12 寸靠进口

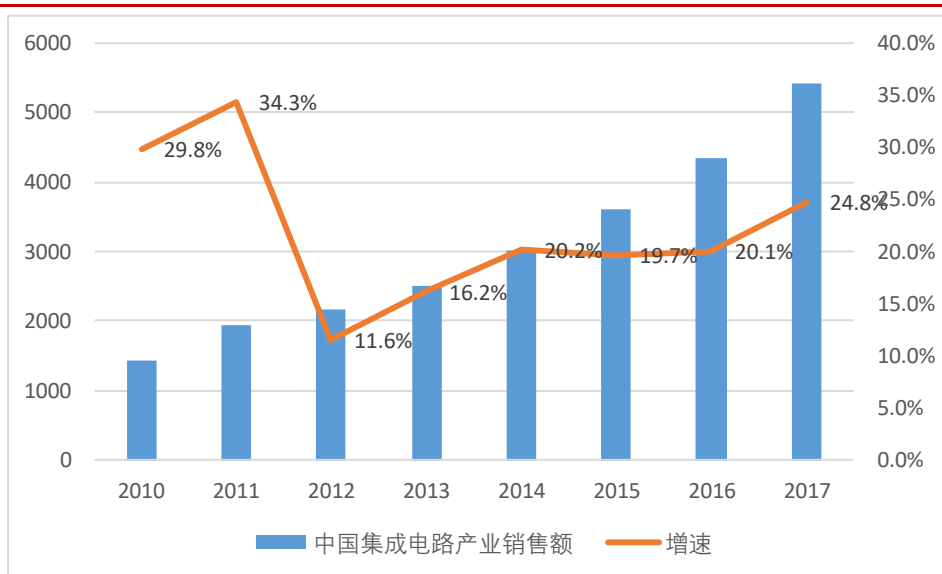
光刻胶	用于显影、刻蚀等工艺，将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基衬底	北京科华、苏州瑞红为主、飞凯材料&强力新材	产品以 LCD、PCB 为主，集成电路用光刻胶主要靠进口，对外依存度 80%以上
电子气体&MO 源	广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺	苏州金宏、佛山华特、大连科利德、巨化股份、南大光电（MO 源）	对外依存度 80%以上
CMP 抛光液	用于集成电路和超大规模集成电路硅片的抛光	上海新安纳、安集微电子	国产化率不到 10%
CMP 抛光垫	用于集成电路和超大规模集成电路硅片的抛光	时代立夫、鼎龙股份（在研）	国产化率不到 5%
电镀液		上海新阳	小部分实现国产替代
超纯试剂	是大规模集成电路制造的关键性配套材料，主要用于芯片的清洗、蚀刻	江化微、晶瑞股份、华谊、上海新阳、凯圣氟等	部分品类国产可满足，国产化率 3 成
溅射靶材	用于半导体溅射	宁波丰电子、有研亿金	大部分进口

资料来源：SEMI，东莞证券研究所

半导体产业加速向国内转移

半导体材料主要应用于集成电路，我国集成电路应用领域主要为计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等，前三者合计占比达 83%。2015 年，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施，国家集成电路产业投资基金开始运作，中国集成电路产业保持了高速增长。根据中国半导体行业协会统计，2015 年中国集成电路产业销售额达到 3609.8 亿，同比增长 19.7%；2016 年中国集成电路产业销售额达到 4335.5 亿元，同比增长 20.1%；2017 年中国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元，同比增长 24.8%；2018 年 1-6 月中国集成电路产业销售额达到 2726.5 亿元，同比增长 23.9%。预计到 2020 年中国半导体行业维持 20%以上的增速。

图7：我国近年来集成电路产业销售额维持20%的增速



资料来源：wind资讯，东莞证券研究所

2014 年 6 月，国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》；2014 年 9 月，为了贯彻《国家集成电路产业发展推进纲要》，正式国家集成电路产业投资基金，由国开金融、

中国烟草、中国移动、紫光通信、华芯投资等企业发起，初期规模 1200 亿元，截止 2017 年 6 月规模已达到 1387 亿元。国家大基金董事长王占甫表示，截至 2017 年 11 月 30 日，大基金累计有效决策 62 个项目，涉及 46 家企业；累计有效承诺额 1063 亿元，实际出资 794 亿元。目前大基金在制造、设计、封测、装备材料等产业链各环节投资布局全覆盖，各环节承诺投资占总投资的比重分别为 63%、20%、10%、7%。前三位企业的投资占比达 70%以上，有力推动龙头企业核心竞争力提升。最新资料显示，大基金一期已投 67 个项目，累计项目承诺投资额达 1188 亿元，实际出资为 818 亿元。

目前大基金第二期方案已上报国务院并获批，正在募集阶段。大基金二期筹资规模有望超过一期，预计在 1500 亿-2000 亿元。按照 1: 3 的撬动社会资本比例，一期加二期总规模预计超过 1 万亿元，这将带动国内集成电路产业加速发展。

表 3：2015 年-2030 年《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

集成电路产业链	2015 年	2020 年	2030 年
材料与设备	65-45nm 关键设备和 12 英寸硅片投入使用	进入国际采购体系	主要环节到达国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队
IC 设计	接近国际一流水平		
IC 制造	32/28nm 量产	16/14 nm 量产	
IC 封测	中高端封装测试收入占比达 30%以上	技术水平达到国际领先水平	

资料来源：《国家集成电路产业发展推进纲要》，东莞证券研究所

另外，由于各地方政府对半导体产业支持力度加大，英特尔、联电、力晶、三星、海力士、中芯国际等大厂纷纷加码晶圆厂建设，根据 SEMI 统计，在 2017-2019 年间，预计全球新建 62 条晶圆加工产线，其中在中国境内新建数量达到 26 条，其中 2018 年，中国大陆计划投产的 12 寸晶圆厂就达 10 座以上；各大 IC 制造业厂商都加码中国市场，扩张 IC 制造产能。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料，对半导体材料的需求将随着增加，上游半导体材料将确定性受益。

表 4：国内在建晶圆产线

厂商	地点	产能（万片/月）	投产时间
格罗方德	成都	未披露	2017 年
晶合	合肥	4	2017 年下半年
武汉新芯	武汉	20	2018 年初
中芯国际	上海	7	2018 年初
中芯国际	深圳	4	2017 年底
晋华集成	泉州	6	2018 年下半年
台积电	南京	2	2018 年下半年
华力微	上海	4	2018 年完工
紫光	深圳	4	2018 年底
兆基科技	合肥	未披露	2018 年
德科玛	南京	2	未披露
士兰微	杭州	5	2018 年

资料来源：SEMI，东莞证券研究所

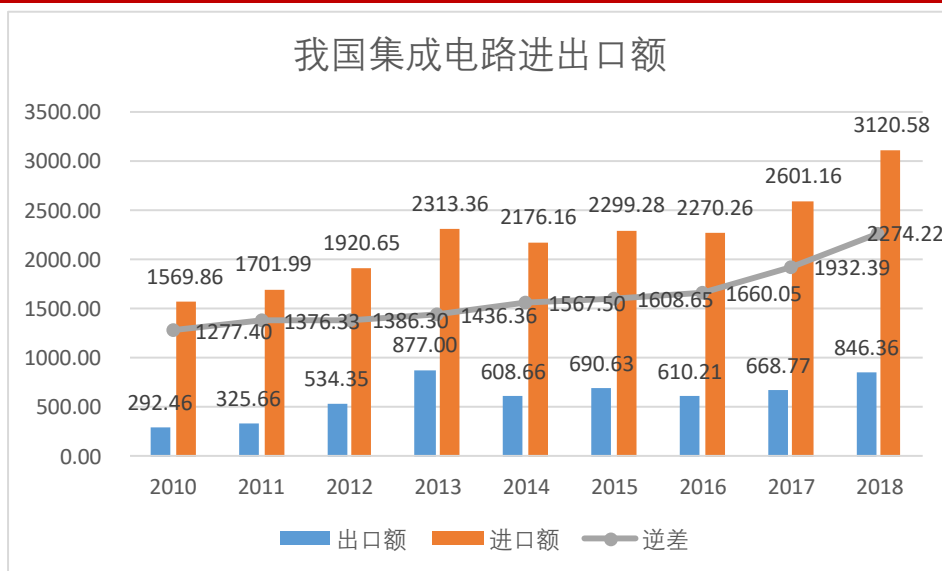
芯片进口替代空间巨大，半导体材料受益

由于我国半导体市场需求巨大，而国内很大一部分不能供给，致使我国集成电路（俗称芯片）进口金额巨大，近几年芯片进口额稳定在 2000 亿美元以上，2017 年我国芯片

进口额为 2601.16 亿美元，同比增长 14.6%；2018 年我国芯片进口额为 3120.58 亿美元，同比增长 19.8%。根据海关数据统计，我国近十年芯片进口额每年都超过原油进口额，2018 年我国原油进口额为 2402.62 亿美元，芯片继续是我国第一大进口商品。

贸易逆差逐年扩大，2010 年集成电路贸易逆差 1277.4 亿美元，而在 2017 年集成电路贸易逆差增长到 1932.4 亿美元，2018 年集成电路贸易逆差 2274.22 亿美元。如此大的贸易逆差反映出我国集成电路市场长期严重供不应求，进口替代的市场空间巨大。

图8：我国集成电路进口额高达2000亿美元之上，进口替代需求大



资料来源：wind资讯，东莞证券研究所

3. 参股公司上海新昇有望成为科创板第一批上市标的

2014 年 5 月 21 日，上海新阳与兴森科技、上海新傲科技股份有限公司、张汝京博士签订《大硅片项目合作投资协议》，拟共同投资设立“上海新昇半导体科技有限公司”，承担 300 毫米半导体硅片项目。上海新昇初始注册资本为 5 亿元。2016 年 5 月，硅产业公司以人民币 3.085 亿元单方面认购上海新昇本次增发的 2.8 亿元注册资本，溢价部分 2850 万元计入上海新昇资本公积。2017 年，公司收购上海皓芯芯管理有限公司持有的上海新晟 3.2051% 的股权，此后合计持有上海新晟股权比例为 27.56%。

上海新昇坐落于临港重装备区内，占地 150 亩，总投资 68 亿元，一期总投资 22 亿元。新昇半导体第一期目标致力于在我国研究、开发适用于 40-28nm 节点的 300mm 硅单晶生长、硅片加工、外延片制备、硅片分析检测等硅片产业化成套量产工艺；建设 300 毫米半导体硅片的生产基地，实现 300 毫米半导体硅片的国产化，充分满足我国大规模集成电路产业对硅衬底基础材料的迫切要求。2018 年底月产能达到 10 万片，2020 年底前将实现月产 30 万片产能目标，最终将达到 100 万片的产能规模。

大硅片项目的牵头人张汝京是中芯国际创始人，具备极其丰富的半导体行业经验，为项目的成功提供了技术保障。硅产业公司由国家集成电路产业投资基金、国盛（集团）有限公司、武岳峰、新微电子、嘉定工业区开发（集团）有限公司发起成立，专注于硅材料产业及其生态系统发展的投资平台，技术及产业背景雄厚，后续将为该大硅片项目提供更有力的支持。

表 5：上海新昇最新股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
上海硅产业投资有限公司	49000	62.82%
上海新阳半导体材料股份有限公司	21500	27.56%
上海皓芯投资管理有限公司	7500	9.62%
合计	78000	100.00%

资料来源：公司公告，东莞证券研究所

目前已经与中芯国际、武汉新芯、华力微电子三家公司签署了采购意向性协议，销售前景明确。自 2017 年第二季度开始有挡片、空片、陪片等测试片的销售，并向中芯国际、上海华力微、武汉新芯等晶圆制造企业提供正片进行认证。2018 年一季度末，上海新昇 300mm 硅片正片通过上海华力微电子有限公司的认证并开始销售。2018 年 12 月 20 日，上海新昇在互动平台上透露，上海新昇公司大硅片已通过中芯国际认证。

上海新昇 2017 年收入为 2470 万元，净利润亏损 2588 万元；2018 年上半年上海新昇营业收入为 7825.89 万元，净利润 1014.56 万元；而第一季度公司收入 2392 万元，净利润-565 万元。随着认证的通过，产品销售将迎来爆发式增长。

图9：12英尺大硅片



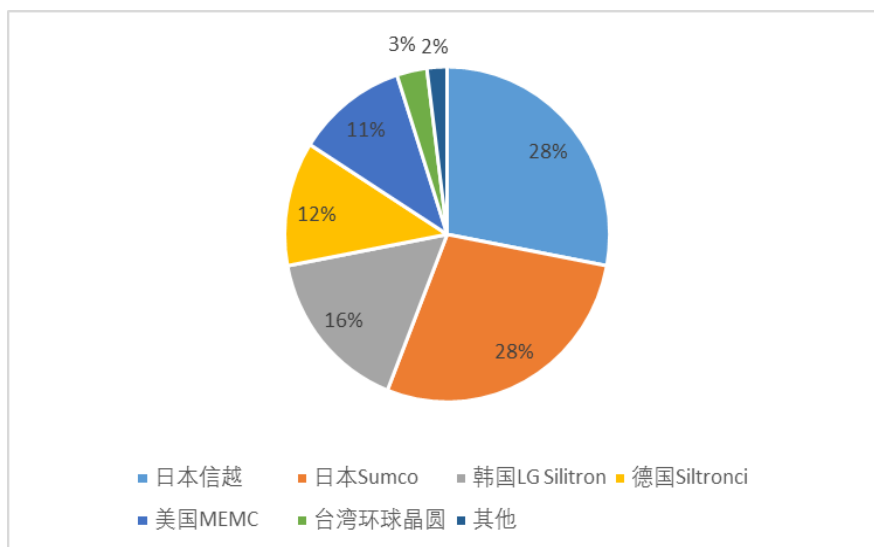
资料来源：上海新昇官网，东莞证券研究所

硅片也称硅晶圆，是最主要的半导体材料，主要包括抛光片、退火片、外延片、节隔离片和绝缘体上硅片，其中抛光片是用量最大的产品，其他的硅片产品也都是在抛光片的基础上二次加工产生的。硅晶圆片的市场销售额占整个半导体材料市场总销售额的 32%~40%。硅片直径主要有 3 英寸、4 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸（300mm），目前已发展到 18 英寸（450mm）等规格。直径越大，在一个硅片上经一次工艺循环可制作的集成电路芯片数就越多，每个芯片的成本也就越低。因此，更大直径硅片是硅片制备技术的发展方向。但硅片尺寸越大，对微电子工艺设备、材料和技术的要求也就越高。

硅片具有极高的技术壁垒，全球市场呈现出寡头垄断的格局，日本信越和 SUMCO（由三菱硅材料和住友材料 Sitix 分部合并而来）一直占据主要市场份额，双方约各占 30%左右，其他主要公司有德国 Siltronic（德国化工企业 Wacker 的子公司）、韩国 LG Siltron、美国 MEMC 和台湾中美硅晶制品 SAS 四家公司。上述 6 家供应商合计占据全球 90%以上的市场份额。目前，国内 8 寸的硅片生产厂商仅有有研新材、金瑞泓等少数厂商，远没有满足国内市场，12 寸硅片目前全部采用进口，可以说是国内半导体产业链上缺失的一

环。

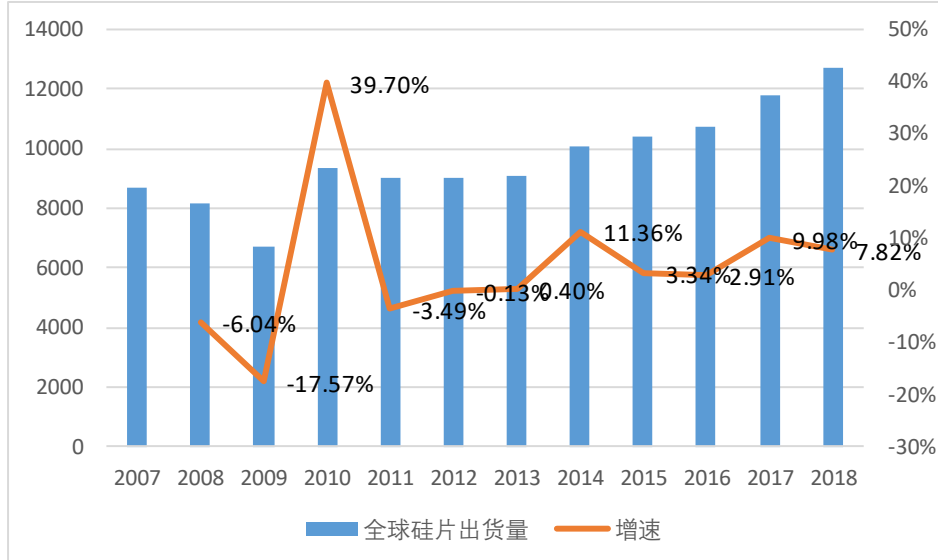
图10：2015 年全球300mm 大硅片市场份额



资料来源：CNKI，东莞证券研究所

目前，硅片主流产品是12英寸，根据SUMCO的预测，300mm总需求将会从2018年的600万片/月增加到2021年的720万片/月，复合增速约为6%。从2013-2018年，全球硅片出货量（应用于半导体生产）稳步增长，2018年全球硅片出货量为12733百万平方英尺，同比增长7.82%。

图11：全球硅片出货量（应用于半导体生产）（单位：百万平方英尺）



资料来源：wind资讯，东莞证券研究所

上海新昇有望成为科创板第一批上市标的

2018年11月，国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布在上海证券交易所设立科创板。中国证监会于2019年1月30日发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、

云计算、人工智能和制造业深度融合，引领中高端消费，推动质量变革、效率变革、动力变革。主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。

上海新昇是我国第一家实现12英寸大硅片量产的国内企业，产品技术门槛非常高，进口替代市场空间非常大，盈利能力强，公司有望成为科创板第一批上市标的。

4. 公司持续高研发投入

国家重大科技专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键技术和重大工程，是我国科技发展的重中之重。该工程源于《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》共确定了16个国家重大科技专项，目前公布了13个，其中第二项为“极大规模集成电路制造设备及成套工艺”，简称“国家02重大科技专项”。作为国家的重大战略产品、关键共性技术和重大工程进行推动，并提供中央财政预算资金支持。

公司连续三次承接“02专项”课题：

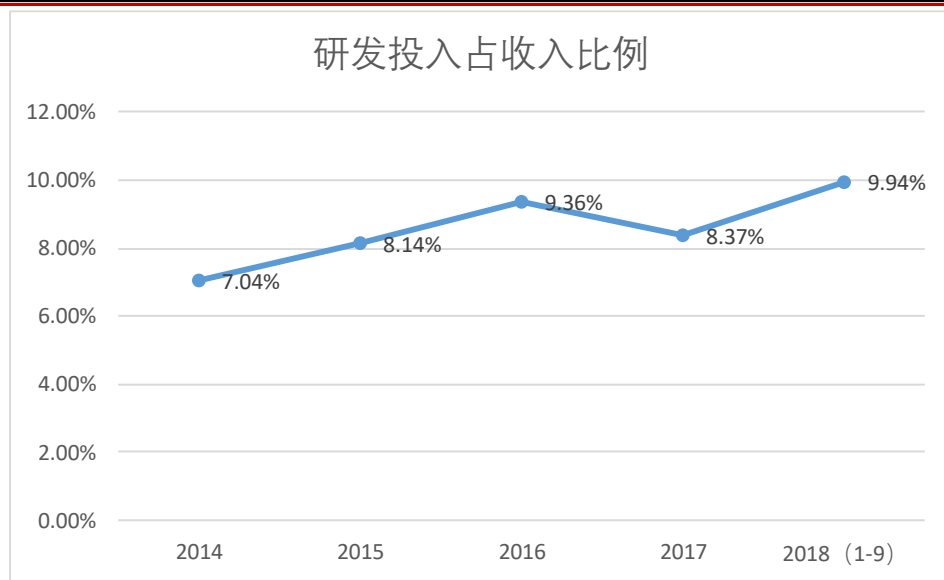
1、2010年，公司作为课题单位承担了国家02重大科技专项——“关键封装设备材料应用工程项目”中的“高速自动电镀线”课题。该项目核定预算总额为1,709.43万元，其中中央财政资金672.47万元。

2、2011年1月，公司接到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的通知，公司申报的“65-45nm芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目已获得国家科技部立项批准，项目资金预算已通过国家财政部投资评审中心评审，该项目总预算为12,000万元，核定中央财政资金预算总额为3,137万元，分三年申报中央财政投入。

3、公司于2016年11月29日确认作为课题责任单位承担“02专项”项目“20-14nm先导产品工艺开发”的课题“铜互连电镀工艺技术及产品的研发”的研发任务，并于当日收到中央财政研发补助款657.05万元，仅该项目的研发经费预算达5719.17万元。课题起止年限为2016年1月至2018年12月，三年中央财政和地方财政支持总计分别为1736.39万元、868.19万元。

2015、2016、2017年公司研发投入金额占营业收入比例分别为8.14%、9.36%、8.37%。2018年前三季度公司研发投入3914万元，同比增长40.67%，占收入比例为9.94%。公司持续高研发投入，提升公司技术优势，为公司未来业绩增长提供支撑。

图12：公司持续高研发投入



资料来源：公司公告，东莞证券研究所

5.投资建议

随着国家坚定推动集成电路产业发展，集成电路存在巨大进口替代空间，我国集成电路迎来黄金发展期。国内外半导体龙头也不断在国内新建产能，半导体产业链将快速发展。上海新阳作为国内的半导体材料龙头企业，可以说是国内半导体材料的稀缺标的，大部分产品是下游主流厂商的国内唯一供应商，公司将充分受益行业景气。我们预计公司2018年、2019年每股收益分别为0.04元、0.46元，目前股价对应PE为702倍、57倍，给予公司“谨慎推荐”投资评级。

风险提示：产品需求低于预期，大硅片项目投产低于预期。

表 6：公司盈利预测简表

科目（百万元）	2016A	2017A	2018E	2019E
营业总收入	414	472	527	632
营业总成本	362	397	548	579
营业成本	233	285	357	417
营业税金及附加	13	11	11	13
销售费用	29	31	35	42
管理费用	73	72	39	44
研发费用	-	-	50	60
财务费用	1	-2	-4	0
资产减值损失	13	-0	61	3
其他经营收益	2	(5)	30	50
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	2	(5)	5	25
其他收益	0	12	25	25
营业利润	53	70	8	103
加 营业外收入	7	0	0	0
减 营业外支出	1	0	0	0
利润总额	60	70	8	103
减 所得税	6	12	1	15
净利润	53	58	7	88
减 少数股东损益	(1)	(1)	(0)	(1)
归母公司所有者的净利润	54	59	7	88
基本每股收益(元)	0.28	0.30	0.04	0.46

数据来源：Wind，东莞证券研究所

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22119430

传真：（0769）22119430

网址：www.dgzq.com.cn